

インターポーザ方式・ソケット Interposer Semi-Custom socket

特 長 【 Features 】

薄型フィルムインターポーザの技術は従来のプローブ技術に取って代わるもので、デバイスとテスト基板の間に挿入し、一時的に接続するために使用します。

Thin Film interposer technologies are an alternative to the traditional probe technology, and are used to provide an electrically transparent temporary connection between devices and test board.

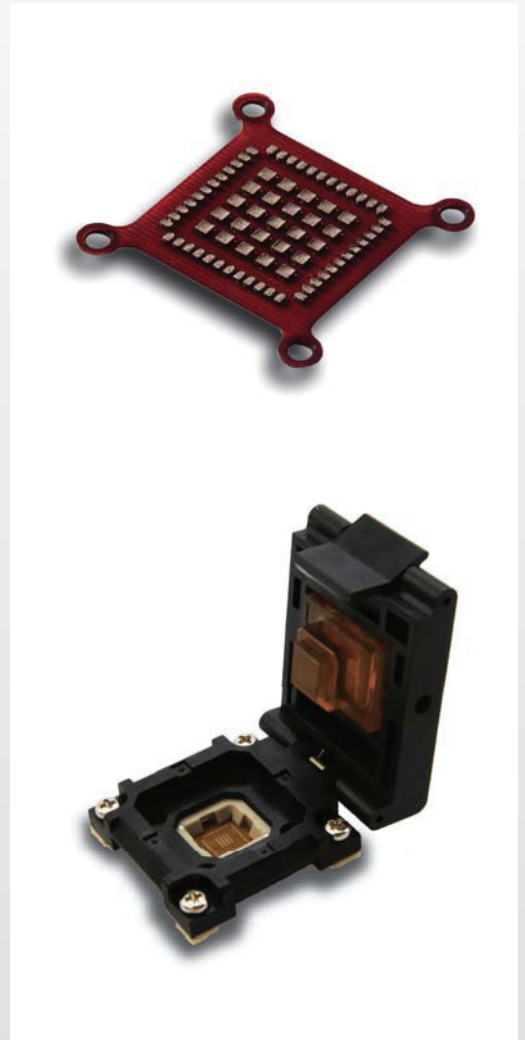
本技術のパッド形式は導電性エラストマーを用いることにより、短い通電距離、低抵抗、低インダクタンス、低静電容量です。このことにより貴社のデバイスのパフォーマンスを最適に計測することができます。

Utilizing a pad defined, isotropic conductive elastomer, the extremely short current path, low resistance, and ultra-low inductance and capacitance of this technology delivers the clearest possible picture of how your devices are performing.

この技術は高周波デバイスや大電流デバイスに特に効果的です。

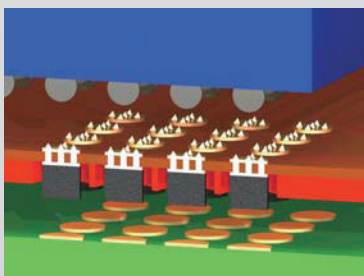
This technology is particularly effective with high-frequency and high-current devices.

◆接触抵抗(Contact DC Resistance)	<80mΩ
◆電流容量(Current Carrying Capabilities)	<2Amps / pin
◆周波数帯域(Bandwidth)	<-1dB through 40GHz
◆自己インダクタンス(Self Inductance)	0.11nH
◆相互インダクタンス(Mutual Inductance)	0.015nH
◆相互キャパシタンス(Mutual Capacitance)	0.005pF
◆コンタクト荷重(Typical Contact Force)	15~25grams / pin
◆圧縮範囲(Contact Compliance)	0.076mm
◆狭ピッチ対応可能(Narrow pitch is applicable)	≧0.2mm

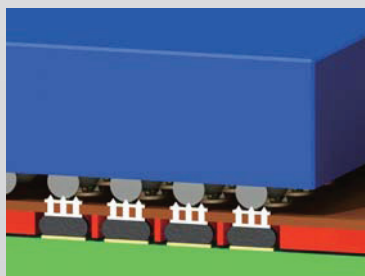


動作説明【How it works】

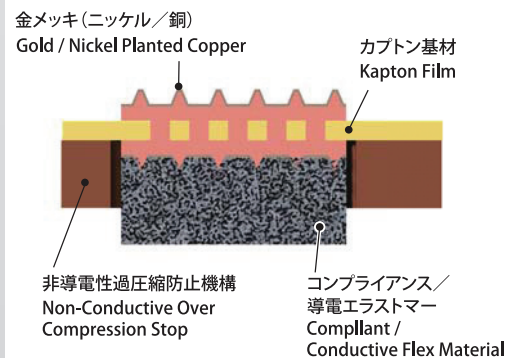
デバイス実装前
Before Compression



デバイス実行後
After Compression



Elastech™
Cross section view



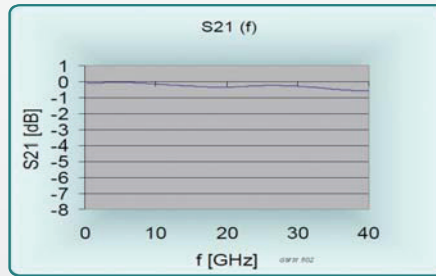
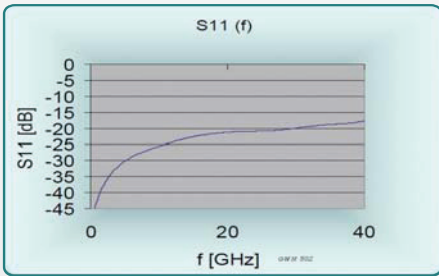
※ Elastech™ はR&D Circuits社の製品です。

インターポザ方式・ソケット/FPCテストコネクタ

Interposer Semi-Custom socket and FPC Test Connector

特 長【 Features 】

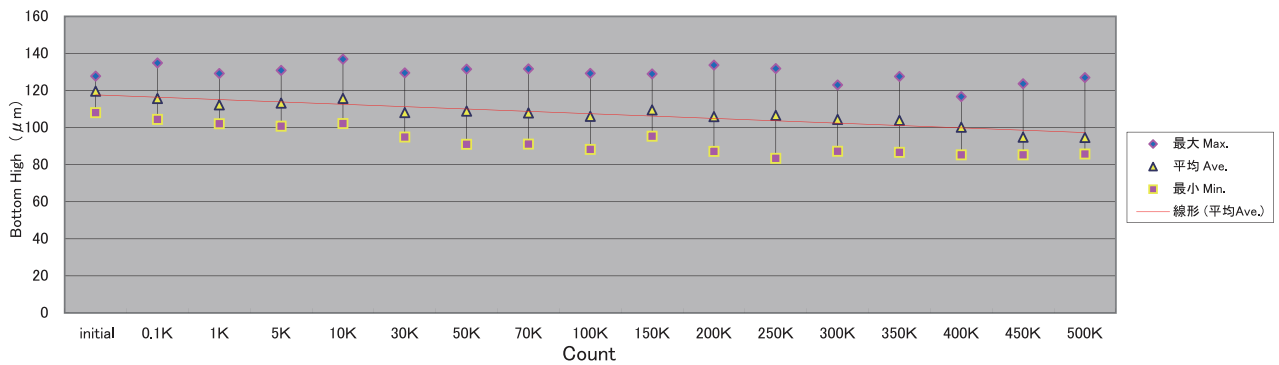
代表高周波特性【 RF Date for G-S-G 】



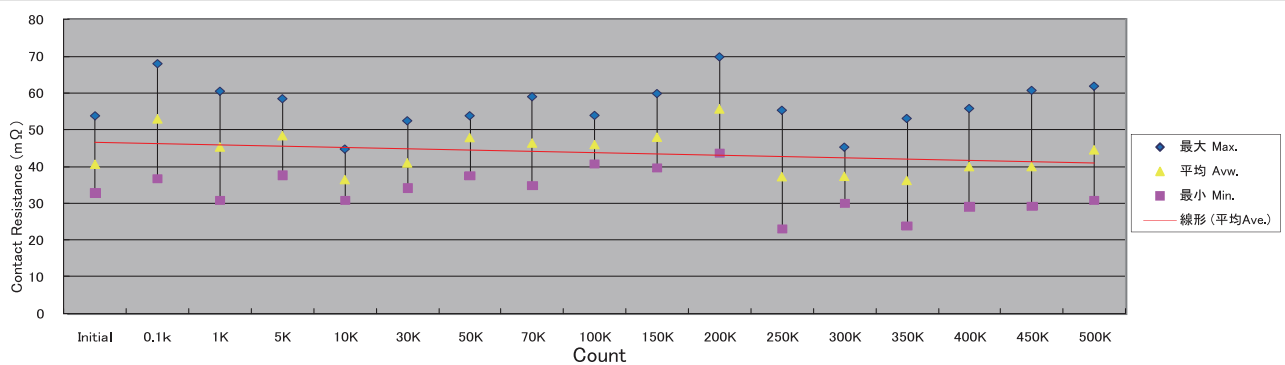
高周波測定条件：
パッド配列：G-S-G 0.5mmピッチ、
但し、測定治具を含みます。

Notes : The pasc between
the signal-the GND is 0.5 mm.
It including measurement jig.

寿命試験【 Life Date of Compliance 】



寿命試験【 Life Date of Resistance 】



ケルビン・コンタクト【 Kelvin Contacts 】

◆ Elastech™ はケルビン接続に適した形状の電極を提案することが出来ます。
形状に合わせてレーザーを使用して微細な凸凹を設け安定した多点接続を可能にします。

Elastech can provide ideal form og the electrobes for Kelvin
connection. Minute convex-concave shaped by laser according to the
form enables stable multi-point connection.

◆レーザーによる微細加工を可能にしているため
最低0.2mmピッチまで対応可能です。

Micro fabrication by laser enables 0.2mm pitch at minimum.

